

中国高性能集成电路市场调研及发展分析报告(2010-2015年)

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国高性能集成电路市场调研及发展分析报告(2010-2015年)》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/109272109272.html>

报告价格：电子版: 6500元 纸介版：6800元 电子和纸介版: 7000

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

集成电路在经历了2010年的高速增长之后，展望2011年，无论是全球市场还是中国市场，市场将会进入平稳发展的阶段，预计市场增速将在10%左右，市场发展的主要驱动力仍然主要来自PC、手机、液晶电视已经其它产量较大的电子产品。此外，未来新兴应用成为市场增长的推动因素之一，xPad等新兴电子产品市场的发展也在一定程度上推动了半导体市场的发展，随着医疗电子、安防电子以及各个行业的信息化建设的持续深入，应用于这些行业的集成电路产品所占的市场比重将会越来越多。根据国家规划，到2015年，国内集成电路产业规模将在2010年的基础上再翻一番，销售收入超过3000亿元，占世界集成电路市场份额提高到14%以上，满足国内30%的市场需求。

面对快速发展并日益变化的市场，《中国高性能集成电路市场调研及发展分析报告(2010-2015年)》将从以下几方面帮助业界券商、投资机构、高性能集成电路生产企业等企业和机构更精确地了解中国高性能集成电路市场的发展现状，更深入地把握中国高性能集成电路市场发展趋势。

通过更加深入、翔实的市场研究数据，抓住最新变化，从下游及消费者对市场进行剖析，总结全球及中国高性能集成电路市场的现状与特点，分析当前存在的问题，使客户全面了解中国高性能集成电路市场的发展状况。

更加全面、深刻的趋势分析与预测。从政策、经济、技术、社会等影响因素综合分析判断高性能集成电路市场趋势及未来规模，使客户提前把握市场需求与发展方向。

精炼各种产品2010年竞争表现。从经营状况、产品与服务、SWOT分析等多个方面总结市场主力企业表现，归纳企业成功要素及发展中存在的问题，分析市场竞争格局。

全面深入的分析用户需求，帮助企业抓住客户心理，调整产品及服务，扩大市场份额。

目录

第一章 高性能集成电路的行业界定 8

第一节 高性能集成电路的定义 8

第二节 高性能集成电路的行业发展历程 8

第三节 高性能集成电路的分类 8

第四节 高性能集成电路的特性 9

第五节 高性能集成电路发展的重要意义 10

第二章 2010-2015年中国高性能集成电路行业发展环境分析 11

第一节 2010-2015年中国经济环境分析 11

一、宏观经济 11

二、工业形势 17

三、消费价格指数分析 21

四、城乡居民收入分析	22
五、全社会固定资产投资和工业投资分析	23
六、进出口总额及增长率分析	24
第二节 2010-2015年中国高性能集成电路的行业发展政策环境分析	25
一、行业发展相关政策	25
颁布时间	25
二、行业政策影响分析	25
三、相关行业标准分析	29
第三节 2010-2015年中国高性能集成电路的行业发展技术环境分析	29
一、技术发展概况	29
二、技术发展趋势分析	32
第四节 "十二五"规划相关解读	33
第三章 2010年中国高性能集成电路发展现状分析	35
第一节 我国高性能集成电路行业发展现状	35
一、国际技术和市场形势分析	35
二、中国本土企业的借鉴经验	37
三、高性能集成电路产业继续突围发展的基本要领	39
第二节 高性能集成电路业：发展模式转型内需拉动回升	40
一、扩内需使行业企稳回升	41
二、产业链上下游重组初现	41
三、高投入和高产出	42
四、国际化发展模式	42
五、周期性运行	42
第三节 中国高性能集成电路行业发展趋势分析	42
一、未来中国高性能集成电路设计产业发展方向	42
二、高性能集成电路封装技术的发展趋势	43
第四章 2010年中国高性能集成电路行业发展分析	45
第一节 2010年中国高性能集成电路的行业发展态势分析	45
第二节 2010年中国高性能集成电路的行业发展特点分析	46
第三节 2010年中国集成电路市场规模达7349.5亿元	47
第四节 2010年中国高性能集成电路的行业市场供需分析	48
一、我国高性能集成电路行业的快速发展与市场供给不足的矛盾依然持续	49
二、未来需求增长 国内集成电路加大产能	49
三、供需趋势预测分析	50
第五章 我国高性能集成电路行业国家发展规划及产业政策	51

第一节 高性能集成电路产业发展规划 51

- 一、产业规划的目标 51
- 二、《规划》实施的重点内容 51
- 三、《规划》面临的形势 52

第二节 国家资源综合利用产业政策分析 53

第三节 国家对高性能集成电路产业的政策 53

- 一、国发〔2000〕18号文 53
- 二、国发〔2011〕4号文 54
- 三、国发[2011]4号与国发[2000]18号、财税[2008]1号文的对比性解读 56

第四节 我国规划将实施的高性能集成电路措施及政策 59

- 一、落实扩大内需措施 59
- 二、加大国家投入 60
- 三、加强策扶持 60
- 四、完善投融资环境 60
- 五、支持优势企业并购重组 60
- 六、进一步开拓国际市场 60
- 七、强化自主创新能力建设 61

第六章 高性能集成电路行业技术分析 62

第一节 中国高性能集成电路行业技术发展现状 62

- 一、高性能集成电路工艺发展现状 62
- 二、高性能集成电路技术现状 66
- 三、高性能集成电路行业技术的更新 66
- 四、技术水平快速提高，技术与产品创新取得显著成果 67

第二节 中国高性能集成电路最新技术动态 67

- 一、我国集成电路攻关喜获成绩 67
- 二、我集成电路装备研发获重大突破 68
- 三、集成电路多项核心技术获突破销售逾百亿 69
- 四、“集成电路装备专项”带动相关产业增长近千亿元 69
- 五、中国集成电路制造水平首次达到国际先进水平 70
- 六、我国集成电路企业努力抢占封测技术高地 70
- 七、我国高性能数模混合集成电路设计获突破 71
- 八、松下半导体公司开发出世界最小集成电路芯片 72

第三节 中国高性能集成电路技术建议及策略 72

- 一、突破集成电路等核心产业的关键技术 73
- 二、技术提升助力发展模式转型 73

第七章 2010年中国高性能集成电路行业重点企业运营财务数据分析 75

第一节 同方股份 75

一、企业概况 75

二、企业财务情况分析 76

三、企业主营业务分析 78

第二节 综艺股份 79

一、企业概况 79

二、企业财务情况分析 80

三、企业主营业务分析 83

第三节 上海贝岭 84

一、企业概况 84

二、企业财务情况分析 85

三、企业主营业务分析 87

第四节 三佳科技 88

一、企业概况 88

二、企业财务情况分析 89

三、企业主营业务分析 92

第五节 通富微电 92

一、企业概况 92

二、企业财务情况分析 93

三、企业主营业务分析 96

第六节 华天科技 96

一、企业概况 96

二、企业财务情况分析 98

三、企业主营业务分析 100

四、企业未来发展的机遇与挑战 101

第七节 长电科技 102

一、企业概况 102

二、企业财务情况分析 103

三、企业主营业务分析 106

第八章 高性能集成电路行业市场竞争策略分析 107

第一节 行业竞争结构分析 107

一、行业产品竞争结构 107

二、行业企业竞争格局 108

三、行业应用领域竞争格局 108

第二节 高性能集成电路的市场竞争策略分析 109

- 一、高性能集成电路的市场增长潜力分析 109
- 二、IP核是我国集成电路设计产业发展重中之重 109
- 三、中国芯片企业猛生 芯片企业数量和质量齐升 110

第三节 高性能集成电路的企业竞争策略分析 111

第九章 高性能集成电路行业投资分析 113

第一节 2010年高性能集成电路行业投资情况分析 113

- 一、中国未来五年将向集成电路行业投资250亿美元 113
- 二、2010、2011年1-2月集成电路及相关行业固定资产投资情况 113
- 三、高性能集成电路行业重点投资方向 120
- 四、高性能集成电路行业投资新方向 120

第二节 高性能集成电路的投资项目分析 121

- 一、寸集成电路项目启动 投资预算亿元 121
- 二、华天科技拟募资8.34亿投资三大集成电路项目 121
- 三、国产极大规模集成电路平坦化材料量产 122
- 四、国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”2011年项目 123
- 五、河南省企业投资项目备案情况 124

第三节 2010年高性能集成电路的投资机会分析 125

第十章 高性能集成电路产业链分析 127

第一节 高性能集成电路行业产业链概况 127

第二节 高性能集成电路上下游行业分析 127

- 一、上游行业垄断程度高 127
- 二、下游行业分析 128

第三节 主要原材料供应及价格分析 128

- 一、高性能集成电路原材料概况 128
- 二、中国多晶硅供求市场分析 129
- 三、日本地震意外拉动多晶硅市场价格上涨 129
- 四、国内高性能集成电路加大产能 上下游芯片需求强劲 130

第十一章 2010-2015年中国高性能集成电路行业发展前景预测分析 132

第一节 高性能集成电路产业发展10年回顾分析 132

- 一、产业规模不断扩大，三业比重渐趋合理 132
- 二、技术水平不断提高，知识产权取得突破 132
- 三、优势企业不断涌现，产业链互动日趋活跃 133
- 四、海内外人才大量汇聚，产业与资本良性互动 133
- 五、公共服务成效显著，产业环境日趋完善 133

第二节 高性能集成电路的行业发展前景分析 134

- 一、金融危机下高性能集成电路的市场的市场前景 134
- 二、2011年高性能集成电路的市场面临的发展商机 135
- 三、“十二五”高性能集成电路产业的发展机遇 135

第三节 高性能集成电路未来发展预测分析 136

- 一、中国高性能集成电路的行业发展规模预测 136
- 二、2010-2015年中国高性能集成电路的行业发展趋势预测 137

第十二章 2010-2015年高性能集成电路行业投资风险分析 139

第一节 当前高性能集成电路的存在的问题 139

第二节 2010-2015年中国高性能集成电路的行业投资风险分析 139

- 一、市场竞争风险 139
- 二、原材料压力风险分析 140
- 三、技术风险分析 140
- 四、政策和体制风险 141
- 五、投融资风险 141
- 六、外资进入现状及对未来市场的威胁 142
- 七、进入退出风险 142
- 八、信贷建议 143

第三节 专家建议 143

图表目录

- 图表 1：2010年12月份及全年主要统计数据 5
- 图表 2：中国高性能集成电路行业主要政策措施一览表 17
- 图表 3：2006 - 2010年中国集成电路市场销售额规模及增长率 39
- 图表 4：新老十八号文主要政策对比表 50
- 图表 5：全球运用纳米技术的集成电路市场预测 57
- 图表 6：集成电路的技术发展趋势图 57
- 图表 7：同方股份概况 66
- 图表 8：2007-2010年同方股份主要财务指标分析 67
- 图表 9：2007-2010年同方股份资产与负债表分析 67
- 图表 10：2007-2010年同方股份利润构成与盈利能力分析 68
- 图表 11：2008-2010年同方股份简要财务指标分析 68
- 图表 12：2007-2010年同方股份经营与发展能力分析 69
- 图表 13：2010年同方股份主营构成分析 69
- 图表 14：综艺股份概况 70
- 图表 15：2007-2010年综艺股份主要财务指标分析 71

- 图表 16 : 2007-2010年综艺股份资产与负债表分析 72
- 图表 17 : 2007-2010年综艺股份利润构成与盈利能力分析 72
- 图表 18 : 2008-2010年综艺股份简要财务指标分析 72
- 图表 19 : 2007-2010年综艺股份经营与发展能力分析 73
- 图表 20 : 2010年综艺股份主营构成分析 74
- 图表 21 : 上海贝岭概况 74
- 图表 22 : 2007-2010年上海贝岭主要财务指标分析 75
- 图表 23 : 2007-2010年上海贝岭资产与负债表分析 76
- 图表 24 : 2007-2010年上海贝岭利润构成与盈利能力分析 76
- 图表 25 : 2008-2010年上海贝岭简要财务指标分析 77
- 图表 26 : 2007-2010年上海贝岭经营与发展能力分析 77
- 图表 27 : 2010年上海贝岭主营构成分析 78
- 图表 28 : 三佳科技概况 78
- 图表 29 : 2007-2010年三佳科技主要财务指标分析 80
- 图表 30 : 2007-2010年三佳科技资产与负债表分析 80
- 图表 31 : 2007-2010年三佳科技利润构成与盈利能力分析 80
- 图表 32 : 2008-2010年三佳科技简要财务指标分析 81
- 图表 33 : 2007-2010年三佳科技经营与发展能力分析 82
- 图表 34 : 2010年中期三佳科技主营构成分析 82
- 图表 35 : 通富微电概况 83
- 图表 36 : 2007-2010年通富微电主要财务指标分析 84
- 图表 37 : 2007-2010年通富微电资产与负债表分析 84
- 图表 38 : 2007-2010年通富微电利润构成与盈利能力分析 85
- 图表 39 : 2008-2010年通富微电简要财务指标分析 85
- 图表 40 : 2007-2010年通富微电经营与发展能力分析 86
- 图表 41 : 2010年通富微电主营构成分析 86
- 图表 42 : 华天科技概况 87
- 图表 43 : 2007-2010年华天科技主要财务指标分析 88
- 图表 44 : 2007-2010年华天科技资产与负债表分析 88
- 图表 45 : 2007-2010年华天科技利润构成与盈利能力分析 89
- 图表 46 : 2008-2010年华天科技简要财务指标分析 89
- 图表 47 : 2007-2010年华天科技经营与发展能力分析 90
- 图表 48 : 2010年华天科技主营构成分析 90
- 图表 49 : 长电科技概况 92
- 图表 50 : 2007-2010年长电科技主要财务指标分析 94

- 图表 51 : 2007-2010年长电科技资产与负债表分析 94
- 图表 52 : 2007-2010年长电科技利润构成与盈利能力分析 94
- 图表 53 : 2008-2010年长电科技简要财务指标分析 95
- 图表 54 : 2007-2010年长电科技经营与发展能力分析 96
- 图表 55 : 2010年长电科技主营构成分析 96
- 图表 56 : 2009年中国高性能集成电路市场产品结构图 97
- 图表 57 : 2010年中国高性能集成电路市场产品结构图 97
- 图表 58 : 2010年中国高性能集成电路市场应用结构 99
- 图表 59 : 2009-2010年1-11月集成电路及相关行业完成投资增速对比情况(%) 103
- 图表 60 : 2010年1-11月集成电路及相关行业固定资产投资完成情况 103
- 图表 61 : 2010年1—11月集成电路及相关行业固定资产投资分省市完成情况 104
- 图表 62 : 2010-2011年1-2月电子信息产业固定资产投资增长情况 106
- 图表 63 : 2011年1-2月集成电路及相关行业投资新开工项目分布情况 106
- 图表 64 : 2010-2011年1-2月集成电路及相关行业完成投资增速对比情况(%) 107
- 图表 65 : 2011年1-2月集成电路及相关行业固定资产投资分行业完成情况 107
- 图表 66 : 2011年-2月集成电路及相关行业固定资产投资分省市完成情况 108
- 图表 67 : 高性能集成电路的行业产业链示意图 115
- 图表 68 : 2011-2013年中国集成电路市场规模及增长率预测 124
- 图表 69 : 集成电路行业各评级因素判断结果 130

《中国高性能集成电路市场调研及发展分析报告(2010-2015年)》系统全面的调研了高性能集成电路的市场宏观环境情况、行业发展情况、市场供需情况、企业竞争力情况、产品品牌价值情况等，旨在为企业提供专项产品深度市场信息，为企业投资、经营决策提供科学参考依据。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/109272109272.html>